

瑞芯微：创新引领前瞻布局 打造“中国芯”成为行业优势企业

——福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行 A 股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

福州瑞芯微电子股份有限公司董事长、总经理
福州瑞芯微电子股份有限公司副总经理、财务总监
福州瑞芯微电子股份有限公司副总经理、董事会秘书
兴业证券股份有限公司投资银行业务总部业务董事、保荐代表人
兴业证券股份有限公司投资银行业务总部董事总经理、保荐代表人

励 民先生
王海闾先生
林玉秋女士
黄 超先生
李 斌先生

福州瑞芯微电子股份有限公司 董事长、总经理励民先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者、网民朋友们：

大家好！

欢迎大家参加福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行 A 股网上投资者交流活动。在此，我谨代表瑞芯微，向关心与支持瑞芯微的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

自 2001 年成立以来，瑞芯微一直从事集成电路设计行业，专注于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户

提供芯片相关产品及技术服务。经过近 20 年的创新发展，公司在音视频编解码、视觉影像处理、软硬件协同开发、多应用平台开发等方面积累了深厚的技术优势，已经成为国内集成电路设计行业的优势企业。

未来，公司将健全技术创新机制，加强人才培养，加大研发投入，充分发挥在音频、视频、感知等方面的技术优势，持续开发性能较为领先的中高端芯片产品，有效巩固消费电子市场份额，加快拓展智能物联应用市场，积极布局人工智能、智能物联等战略性新兴产业，协调推进电源管理芯片市场，力争开发出国内一流、具有国际竞争力的芯片产品及应用方案，努力发展成为具有国际竞争力的集成电路设计企业。

通过本次网上路演，我们希望广大投资者能够对瑞芯微有一个更全面的了解。今后，瑞芯微的发展将与广大投资者的利益紧密相连，期盼得到您更多帮助与支持。我们也将借助资本市场这一更高更广阔的平台，努力创造更加优良的业绩，回报广大投资者的信任，回馈社会！

谢谢大家，祝愿明天会更好！

兴业证券股份有限公司 投资银行业务总部业务董事、保荐代表人 黄超先生致辞



尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

欢迎各位参加福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行 A 股网上投资者交流活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商兴业证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

在与瑞芯微的合作过程中，我们亲

眼见证了公司近年来的发展。瑞芯微坚持“创新引领、前瞻布局”的发展战略，以市场需求为导向，以持续创新为驱动，以核心技术为支撑，专注于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售。公司本次股票发行募集的资金将用于“研发中心建设项目”、“新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理器芯片的升级项目”、“面向语音或视觉处理的人工智能系列 SoC 芯片的研发和产业化项目”和“PMU 电源管理芯片升级项目”。随着募投项目的顺利实施，瑞芯微将实现产品性能的提升、产品系列的增加和应用领域的拓展，从而提高公司的市场竞争力和盈利能力，为广大投资者带来满意的回报。

同时，我们也真诚地希望通过本次网上路演，让广大投资者更加充分地了解瑞芯微的投资价值，把握投资机会，共同分享优秀企业的发展成果。欢迎大家踊跃提问。

最后，预祝福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行 A 股上市取得圆满成功！谢谢大家！

福州瑞芯微电子股份有限公司 副总经理、董事会秘书林玉秋女士致结束语



尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行 A 股网上投资者交流活动已经接近尾声。十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这么好的沟通平台和优质的服务。借此机会，还要感谢保荐机构兴业证券及其他所有为瑞芯微发行上市辛勤付出

的中介机构！

今天，有机会与这么多关心、关注瑞芯微的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，在今后的经营管理中我们一定会认真考虑这些意见和建议，并把朋友们的真知灼见融入到瑞芯微的经营管理工作之中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但瑞芯微与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来瑞芯微进行实地考察。

我们真诚希望能够通过今天的网上路演，通过彼此间坦诚的交流，来开启瑞芯微与各位投资者朋友紧密沟通的大门。热忱期待着您们成为我们的股东，与我们携手共创瑞芯微的美好未来！

最后，再次感谢各位投资者对瑞芯微的信任与支持！谢谢大家！



路演嘉宾合影

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

励民：公司主营业务为大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片相关产品及技术服务。自成立以来，公司一直从事集成电路设计行业，是国家级高新技术企业和经工业和信息化部认定的集成电路设计企业。经过近二十年的创新发展，公司已经成为国内集成电路设计行业的优势企业。

问：公司的芯片产品主要应用在哪些领域？

黄超：目前，公司的芯片产品主要包括消费电子和智能物联应用处理器 SoC 芯片及电源管理芯片。消费电子市场以个人消费者为主，公司的 SoC 芯片主要应用于平板电脑、智能盒子、智能手机等消费电子产品。在消费电子应用领域，公司的高端 SoC 芯片产品正逐步进入国际高端消费电子市场；智能物联市场以商业应用为主，公司的 SoC 芯片广泛应用于智慧商显、智能零售、汽车电子、智能安防等智能物联硬件。在智能物联应用领域，公司是国内少数具备国际竞争力的设计企业之一，有效地带动了传统产业的转型升级，服务、支持和促进了新经济的发展；在电源管理应用领域，公司为国内主要手机厂商定制开发了低压大电流高集成度快速充电管理芯片，性能和可靠性指标均处于市场领先水平。此外，公司在构建较为丰富产品线、拓展产品应用领域的同时，积极布局人工智能领域，已陆续推出多款人工智能芯片相关产品。

问：公司的参控股公司有哪些？

林玉秋：截至招股说明书签署日，瑞芯微拥有 3 家全资子公司：瑞芯微电子（香港）有限公司、上海翰迈电子科技有限公司、杭州拓欣科技有限公司；1 家参股子公司：杭州地芯科技有限公司。

问：公司获得过哪些科研方面的奖项？

李斌：公司被评为十年（2001-2010）中国芯领军设计企业、中国软件信息服务业“创新影响力企业”、福建省知识产权优势企业、福建省软件骨干企业，曾获福建省科技进步一等奖，芯片产品先后荣获第十一届、第十四届中国国际软件博览会金奖，并多次获得工业和信息化部软件与集成电路促进中心、中国电子信息产业发展研究院评选的“中国芯”奖项。

问：请介绍下公司的研发费用情况。

王海闾：2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1 月到 6 月，公司研发费用分别为 26711.22 万元、24720.28 万元、25497.68 万元和 13569.61 万元，占营业收入的比例分别为 20.58%、19.77%、20.06%和 23.63%，占比较高且呈上升趋势，与公司坚持自主创新、重视研发设计和持续开发新产品的研发模式相匹配。

发展篇

问：公司的总体发展目标是什么？

林玉秋：公司业务发展的总体目标是：以国家大力促进集成电路产业发展为契机，以市场需求为导向，以自主创新为驱动，以核心技术为支撑，加强战略谋划和前瞻布局，准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势，健全技术创新投入、研发、应用机制，加强人才培养，加大研发投入，充分发挥在音频、视频、感知等方面的技术优势，持续开发性能较为领先的中高端芯片产品，有效巩固消费电子市场份额，加快拓展智能物联应用市场，协调推进电源管理芯片市场，积极布局人工智能、智能物联等战略性新兴产业，力争开发出国内一流、具有国际竞争力的芯片产品及应用方案，更加直接、有效地服务、支持、促进新经济的发展和传统产业的转型升级，努力发展成为具有国际竞争力的集成电路设计企业。

问：公司在技术研发方面有什么计划？

励民：公司将重点围绕高性能、降低功耗及拓展新应用领域等方面开展技术研发工作，主要计划如下：1）加强基础技术的研究和积累；2）开发工艺更为先进的芯片产品；3）加快布局人

工智能芯片；4）深化产业链技术协同。

问：公司的研发技术优势有哪些？

励民：长期以来，公司通过持续的技术创新和技术积累，构建了核心技术群以及知识产权体系。截至查询日，公司已取得 398 项专利，其中 376 项发明专利，22 项实用新型专利；207 项计算机软件著作权、27 项集成电路布图设计登记，在高性能和低功耗的平衡设计、高集成度高可靠性、智能化的电源管理芯片设计、超高清视频编解码、高品质音频信号处理、影像及视觉处理、软硬件协同 SoC 设计、多应用平台下的软件开发等方面拥有自主知识产权或核心技术，具有领先的技术优势。

问：公司在客户资源方面有什么优势？

励民：凭借领先的芯片设计技术、较强的应用开发能力及优质的客户服务水平，公司先后与英特尔合作推出 SoFIA 3GR 芯片产品，与三星、谷歌合作推出 Chromebook 笔记本电脑，与宏碁、谷歌合作推出 Chromebook 平板电脑。此外，公司芯片产品还获得索尼、华为、OPPO、VIVO、华硕、海尔、腾讯等国内外品牌商的采用。

问：公司财务状况的未来趋势如何？

王海闾：作为集成电路设计企业，公司采用 Fabless 经营模式，专注于大规模集成电路及应用方案的研发、设计和销售，将产业链中的生产环节外包给专业厂商，减少了对生产类固定资产的投入，资产结构呈现出以流动资产为主的“轻资产”特点，资产运营效率较高，周转能力较强。

近年来，公司凭借领先的技术优势、专业的研发团队和快速的市场响应，实现了净利润和经营净现金流量的快速增长，提升了公司的抗风险能力，公司流动比率、速动比率均处于较高水平，负债结构合理。但是，公司所处行业为研发投入密集型行业，需要持续投入大量的研发费用，才能保持技术和产品的领先优势。本次股票发行并上市后，公司的权益性资产和资产总额将进一步增加，营运资金将进一步充实，资产负债结构将更加稳健。

未来，公司将坚持稳健的财务政策，结合公司发展规划和募集资金投资项目，不断开发新产品，提升技术设计和开发水平，对现有产品结构进一步扩展和延伸，扩大经营活动产生的现金流量，保持良好的财务状况。

问：公司盈利状况的未来趋势如何？

王海闾：公司坚持“创新引领、前瞻布局”的发展战略，在新产品的开发和现有产品的升级等方面具有较强的主动性和前瞻性。面对市场的快速变化，公司以自主创新为驱动，主动调整业务战略，快速、有效地推进产品的更新、换代，研发、设计出多款性能领先的芯片产品及应用方案，满足终端消费者的多样化需求。再加上长期以来较为成功的品牌运营和优质客户累积，实现了报告期内公司利润规模的较快增长，盈利能力的较快提升。

未来，公司将把握新一轮科技革新带来的市场机遇，结合战略发展目标，借助本次募集资金投资项目，在巩固和优化自身核心技术的同时，对人工智能产业链进行深度布局，培育一批具有较高附加值的中高端芯片产品，重点开发人工智能、智能物联等战略新兴领域的应用方案，不断拓展产品应用领域，确保公司业务规模和盈利能力持续增长。

行业篇

问：公司所处行业是什么？

林玉秋：根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“C 制造业—C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

问：集成电路设计行业未来的发展趋势是什么？

励民：集成电路设计需要融合高等工程数学、半导体器件物理、固体电子学、电子信息材料与技术、数字 / 模拟集成电路、集成电路与片上系统等多种技术，跨越多个学科，行业具有较高

的技术门槛，需要较长时间的技术积累。晶圆制造、封装测试技术的改良、终端硬件性能的提升及新型应用领域的拓展，又对集成电路设计提出了新的、更高的要求，集成电路设计行业的发展趋势如下：1）新应用领域带动高性能高扩展性 SoC 产品的需求提升；2）IC 设计更加注重影像处理、视觉分析和深度学习能力；3）集成电路设计行业在产业链中的占比将持续提升。

问：有利于集成电路设计行业发展的因素有哪些？

黄超：有利于集成电路设计行业发展的因素有：1）国家产业政策大力扶持；2）集成电路产业基础良好；3）终端应用市场快速发展。

问：公司有哪些同行业可比上市公司？

李斌：基于相关性和可比性原则，综合考虑同行业上市公司的业务模式和产品结构，公司选取珠海全志科技股份有限公司、中颖电子股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司、圣邦微电子（北京）股份有限公司、深圳市富满电子集团股份有限公司、晨展半导体（上海）股份有限公司等 6 家公司作为同行业可比上市公司。上述公司的芯片产品或应用领域，与公司较为接近或有所重叠。除深圳市富满电子集团股份有限公司部分封装测试自行生产完成外，上述公司均采取 Fabless 模式，主要从事集成电路设计，芯片制造、封装和测试等主要通过委外方式实现。

发行篇

问：请介绍下公司股东中的外资股份和国有股份情况。

林玉秋：截至招股说明书签署日，公司股东国家集成电路基金、上海科投为国有股东，分别持有公司 2591.96 万股、90.00 万股的股份，占公司股份总数的 7.00%、0.24%。公司不存在外资股东的情形。

问：请介绍下本次发行情况。

林玉秋：公司本次公开发行不超过 4200 万股，占本次公开发行股票后公司股份总数的比例不低于 10%，发行后总股本不超过 41228 万股。

问：此次募集资金有什么用途？

黄超：本次公司发行股票所募集的资金将用于投资以下项目：1）研发中心建设项目，项目投资总额为 5619.16 万元，拟投入募集资金净额为 5619.16 万元；2）新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理器芯片的升级项目，项目投资总额为 26657.76 万元，拟投入募集资金净额为 13563.21 万元；3）面向语音或视觉处理的人工智能系列 SoC 芯片的研发和产业化项目，项目投资总额为 14301.21 万元，拟投入募集资金净额为 12301.21 万元；4）PMU 电源管理芯片升级项目，项目投资总额为 2218.53 万元，拟投入募集资金净额为 2218.53 万元。

问：请介绍下研发中心建设项目的概况。

黄超：公司拟投资 5619.16 万元用于研发中心建设项目，搭建与公司未来业务发展相适应的高效技术创新平台，持续提高 SoC 芯片产品的性能和附加值，为公司长远发展提供有力的技术支持。项目建设内容主要包括：更新、添置研发设计相关设备，包括综合测试仪、仿真器、频谱分析仪、网络分析仪等实验室设备，服务器、存储器等硬件设备，IP 核、EDA 设计工具等技术授权等；组织开展技术人员招聘和培训等。研发项目的主要方向包括：支持多核 CPU 与 GPU 及高清视频处理的高效高速系统架构，新一代的低功耗技术，无线网络连接和射频技术等。

文字整理 姚桐

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com) 特别支持

